



2025年3月期
決算説明会

2025年6月4日

株式会社 **立花エレクトック**

証券コード：8159

会社概要



代表者

代表取締役社長 社長執行役員

布山 尚伸



創業104年

1921年(大正10年)創業



東証プライム市場

証券コード:8159



連結年間売上高

2,201億円

(2025年3月期実績)



従業員数

連結1,478名

(2025年3月期)



大株主

(2025年3月期)

三菱電機	8.36%
サンセイテクノス	7.23%
日本マスター	
トラスト信託	6.93%
三菱UFJ銀行	4.71%
きんでん	3.28%

資本金

58億7,400万円

(2025年3月期)



自己資本比率

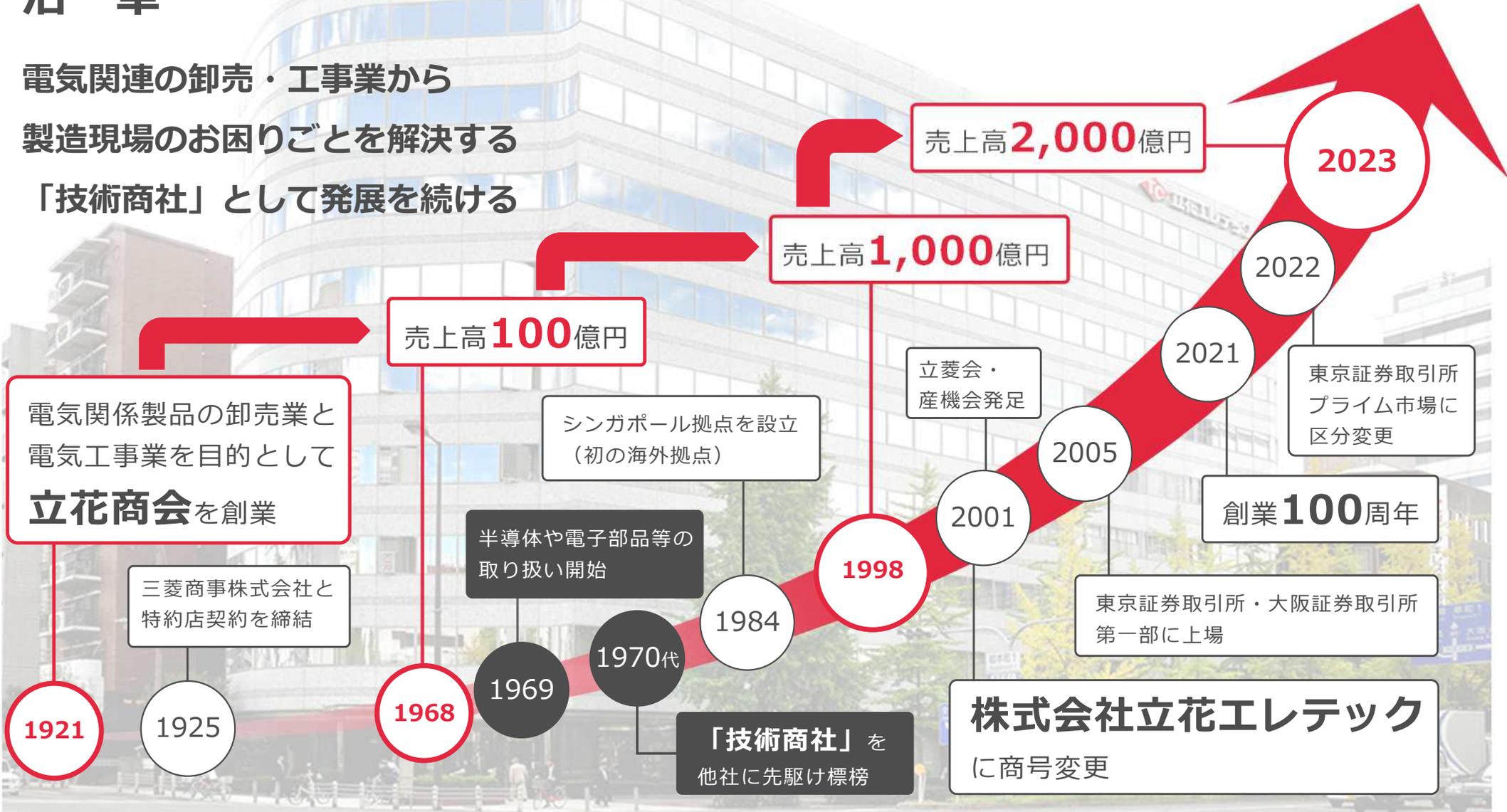
57.4%

(2025年3月期)



沿革

電気関連の卸売・工事業から
製造現場のお困りごとを解決する
「技術商社」として発展を続ける



国内営業拠点

国内 **19** 拠点

子会社 **6** 社 **30** 拠点

- 研電工業(株)
- (株)立花宏和システムサービス
- (株)大電社
- (株)立花デバイスコンポーネント
- (株)タカギコネクト
- (株)立花電子ソリューションズ

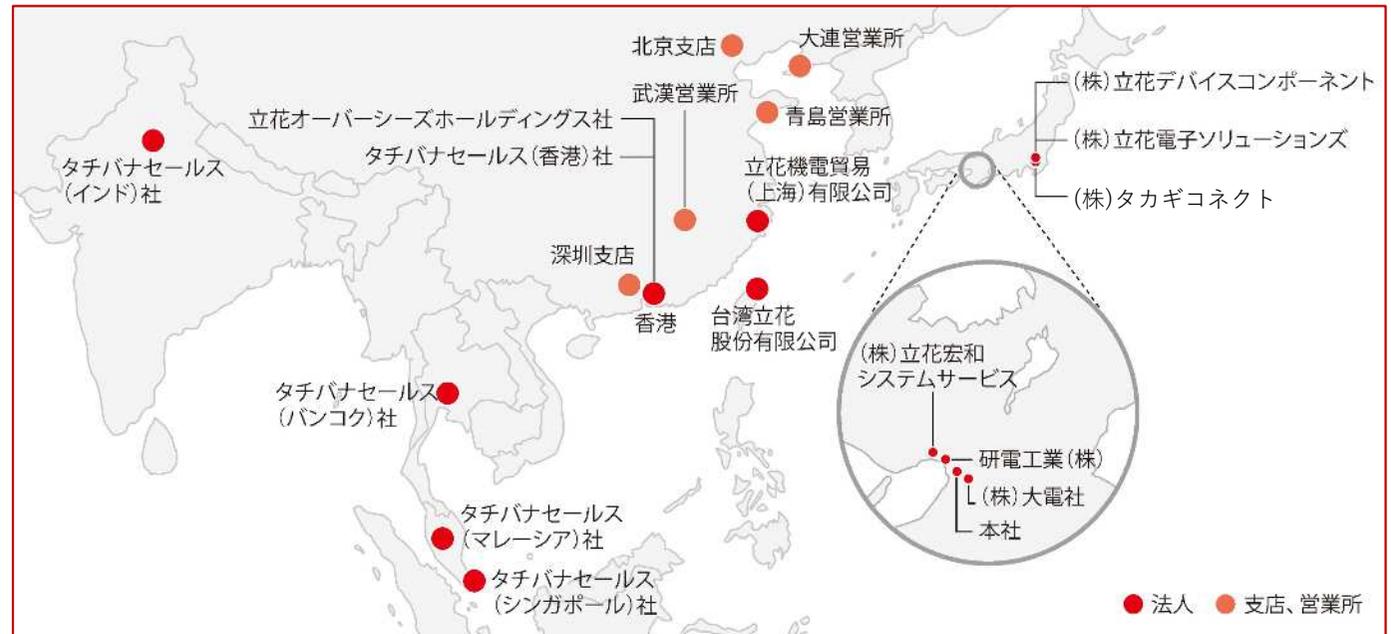


<2025年3月末現在>

海外営業拠点

海外子会社 **10**社 合計 **15**拠点

- 立花オーバーシーズホールディングス社
- タチバナセールス(シンガポール)社
- タチバナセールス(香港)社
- 台湾立花股份有限公司
- 立花機電貿易(上海)有限公司
- タチバナセールス(バンコク)社
- タチバナセールス(マレーシア)社
- 高木(香港)有限公司
- 高機国際貿易(上海)有限公司
- タチバナセールス(インド)社



<2025年3月末現在>

事業ドメイン



FAシステム事業

FA機器部門

プログラマブルコントローラー、インバーター、ACサーボ、各種モーター、配電制御機器

FAシステムソリューション部門

生産設備を監視・計測・制御するシステム構築とソリューションの提供、ロボットシステムの販売

産業メカトロニクス部門

産業用ロボット、放電加工機、レーザー加工機、3Dプリンター

産業デバイスコンポーネント部門

コネクタ、エンベデッド機器、産業用パソコン、タッチパネルモニター



半導体デバイス事業

半導体 (パワー半導体、メモリー、アナログIC、ロジックIC)
電子デバイス (メモリーカード、密着イメージセンサー、液晶)



施設事業

パッケージエアコン他空調機器、LED照明、太陽光発電システム、オール電化機器、ルームエアコン、昇降機、受変電設備機器、監視制御装置



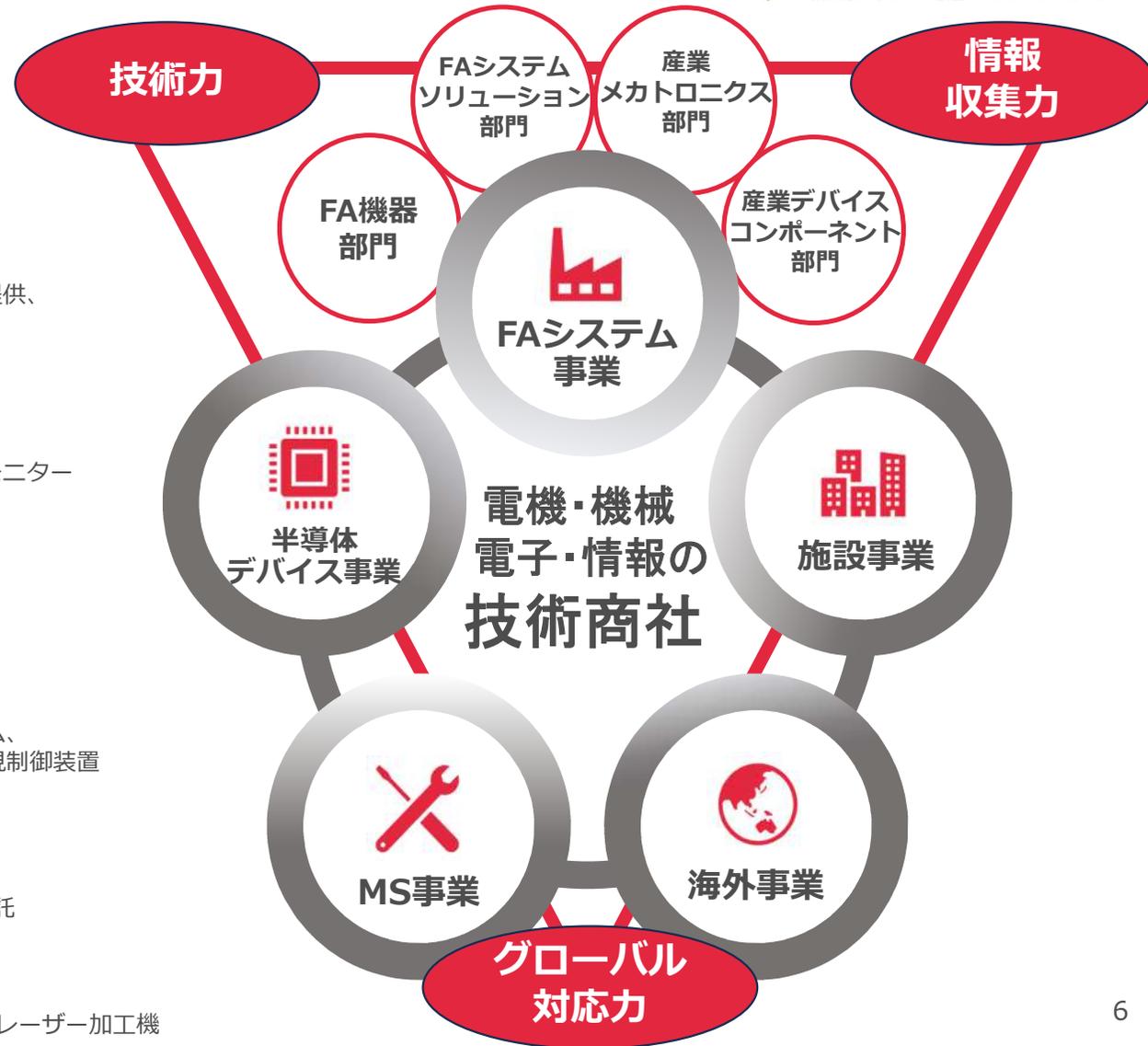
MS事業

(EMS) 電子機器の基板から完成品までの設計・製造受託
(MMS) 立体駐車場・流通向けラック用金属部材の加工・製造受託

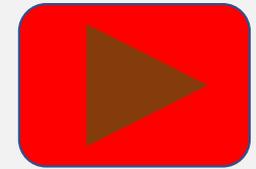


海外事業

(中国、インド、ASEAN向け) 各種半導体、FA機器、放電加工機、レーザー加工機



当社紹介ビデオをご覧ください



- 01 2025年3月期：決算概要
- 02 2026年3月期：業績予想
- 03 中長期経営計画
「NEW C.C.J2200」
- 04 株主還元/株式情報
- 05 トピックス

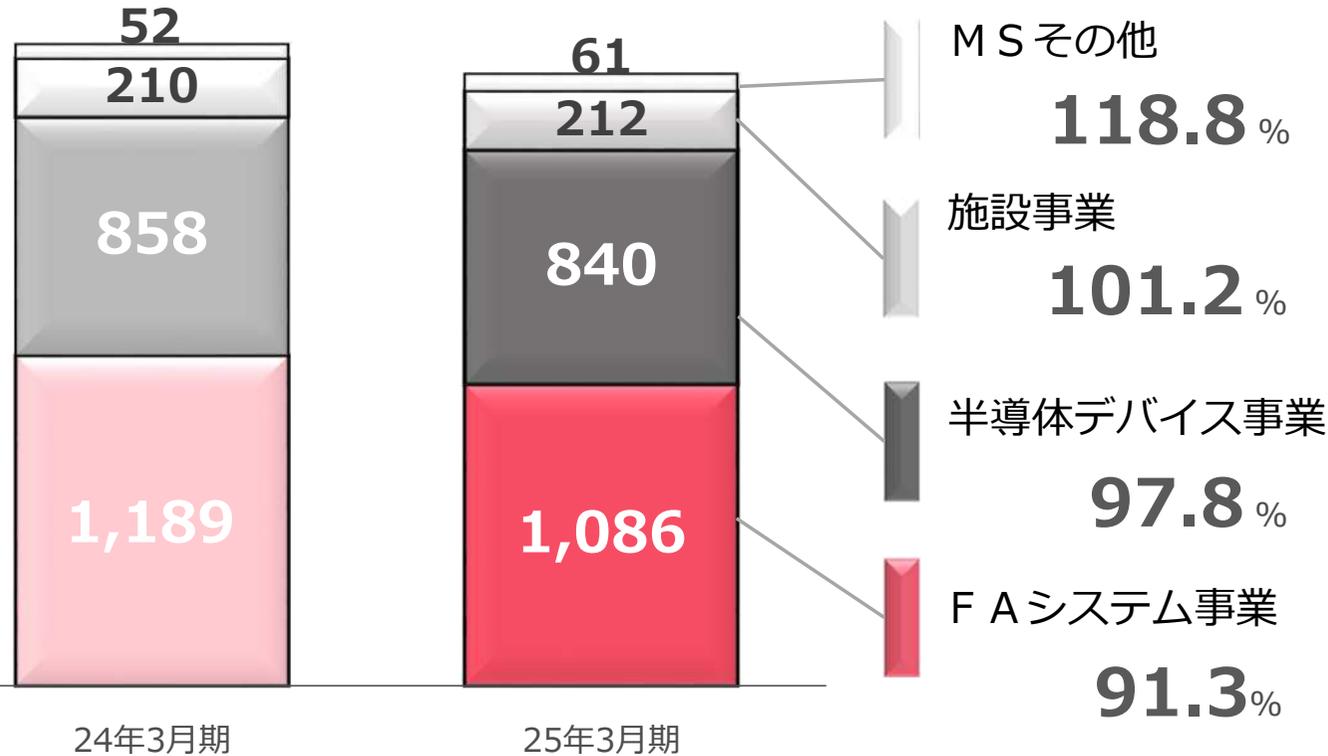
01 2025年3月期：決算概要

2025年3月期：連結決算概要（5/12発表）

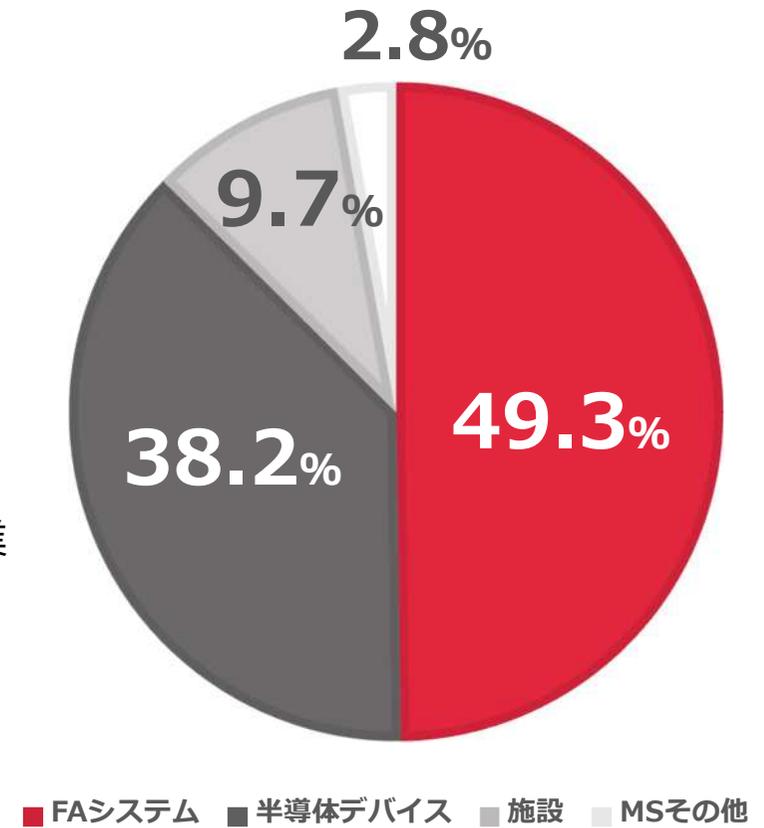
	2024年3月期	2025年3月期	前年比	
売上高	2,310 億円	2,201 億円	▲109 億円	95.3 %
営業利益	107	82	▲25	76.4
経常利益	118	86	▲32	73.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	84	70	▲14	83.2

連結のセグメント別売上高 (2025年3月期)

2,310 億円 2,201 億円 前年比 95.3 %



事業別売上高構成比



財務状態 (連結貸借対照表)

単位：百万円

資産の部	24年3末	25年3末	増減
流動資産合計	141,762	130,240	11,522
現金及び預金	14,945	24,069	9,124
受取手形、売掛金及び契約資産	77,908	67,018	△10,890
商品	43,280	34,818	△8,462
その他	5,627	4,333	△1,294
固定資産合計	36,518	35,175	△1,343
有形固定資産	6,109	5,164	△945
無形固定資産	914	1,262	348
投資その他の資産合計	29,495	28,748	△747
(内) 投資有価証券	(26,412)	(25,794)	(△618)
資産合計	178,281	165,416	△12,865

自己資本比率: 24/3期 51.9%、25/3期 57.4%

ROE: 24/3期 9.6%、25/3期 7.5%

負債の部	24年3末	25年3末	増減
流動負債合計	73,753	57,733	△16,020
支払手形及び買掛金	56,015	44,563	△11,452
短期借入金	7,784	3,267	△4,517
その他	9,954	9,903	△51
固定負債合計	11,955	12,690	735
長期借入金	6,816	7,250	434
退職給付に係る負債	622	669	47
その他	4,517	4,771	254
負債合計	85,709	82,016	△15,286
純資産の部			
株主資本合計	80,076	82,016	1,940
資本金	5,874	5,874	0
資本剰余金	6,146	6,146	0
利益剰余金	71,066	75,741	4,675
自己株式	△3,010	△5,746	△2,736
その他の包括利益累計額	12,495	12,976	481
純資産合計	92,572	94,992	2,420
負債純資産合計	178,281	165,416	△12,865

02 2026年3月期：業績予想

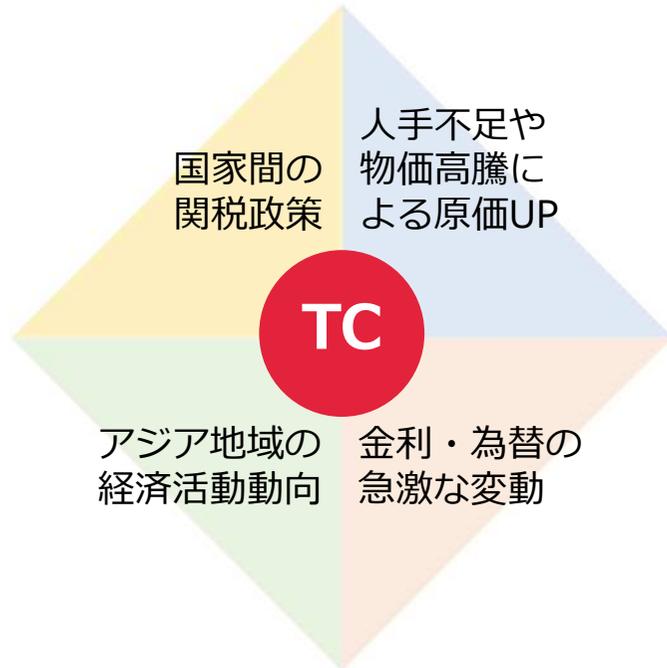
2026年3月期：連結業績予想

	2025年3月期	2026年3月期予想		前年比
売上高	2,201 億円	2,250 億円	49 億円	102.2 %
営業利益	82	75	▲7	91.2
経常利益	86	80	▲6	92.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	70	55	▲15	78.1
1株当たり 当期純利益	299.74 円	239.37 円	▲60.37 円	

当期の見通し

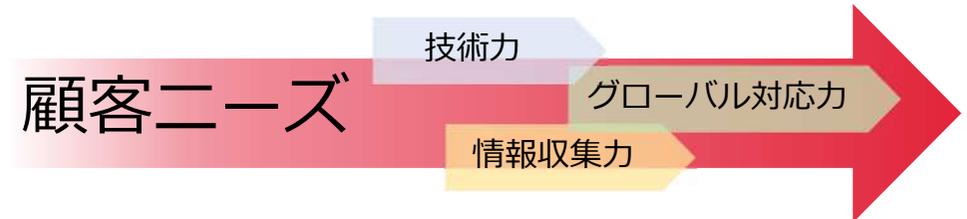
■ 当社を取り巻く環境

不透明な社会情勢が続く



■ 方向性

- ・ ソリューションビジネスに注力



- ・ 200年企業への経営基盤強化



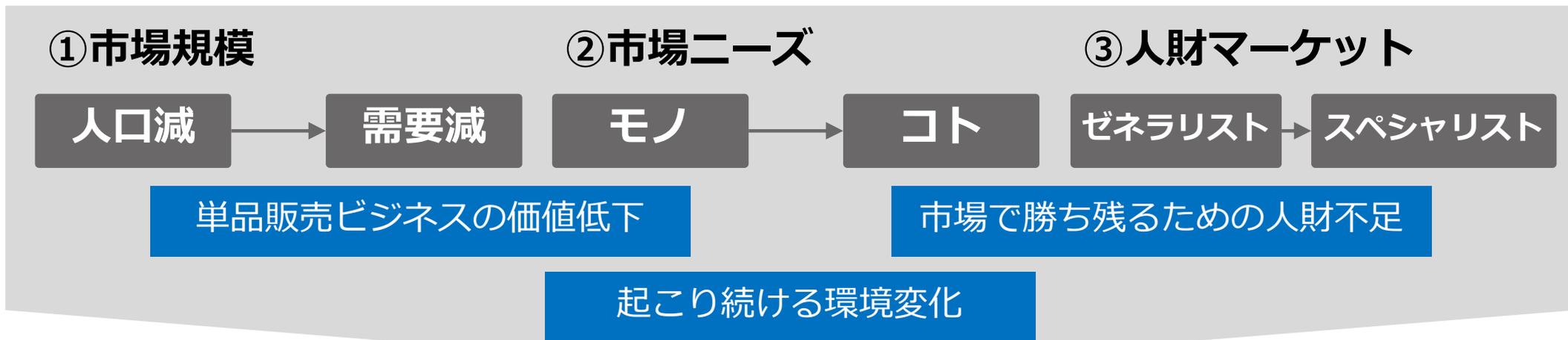
次世代の100年

03

中長期経営計画

「NEW C.C.J2200」

**～2026年3月期を最終年度
とする5カ年計画～**



NEW C.C.J2200

200年企業になるための基盤づくり

新しい時代に適合した
営業戦略

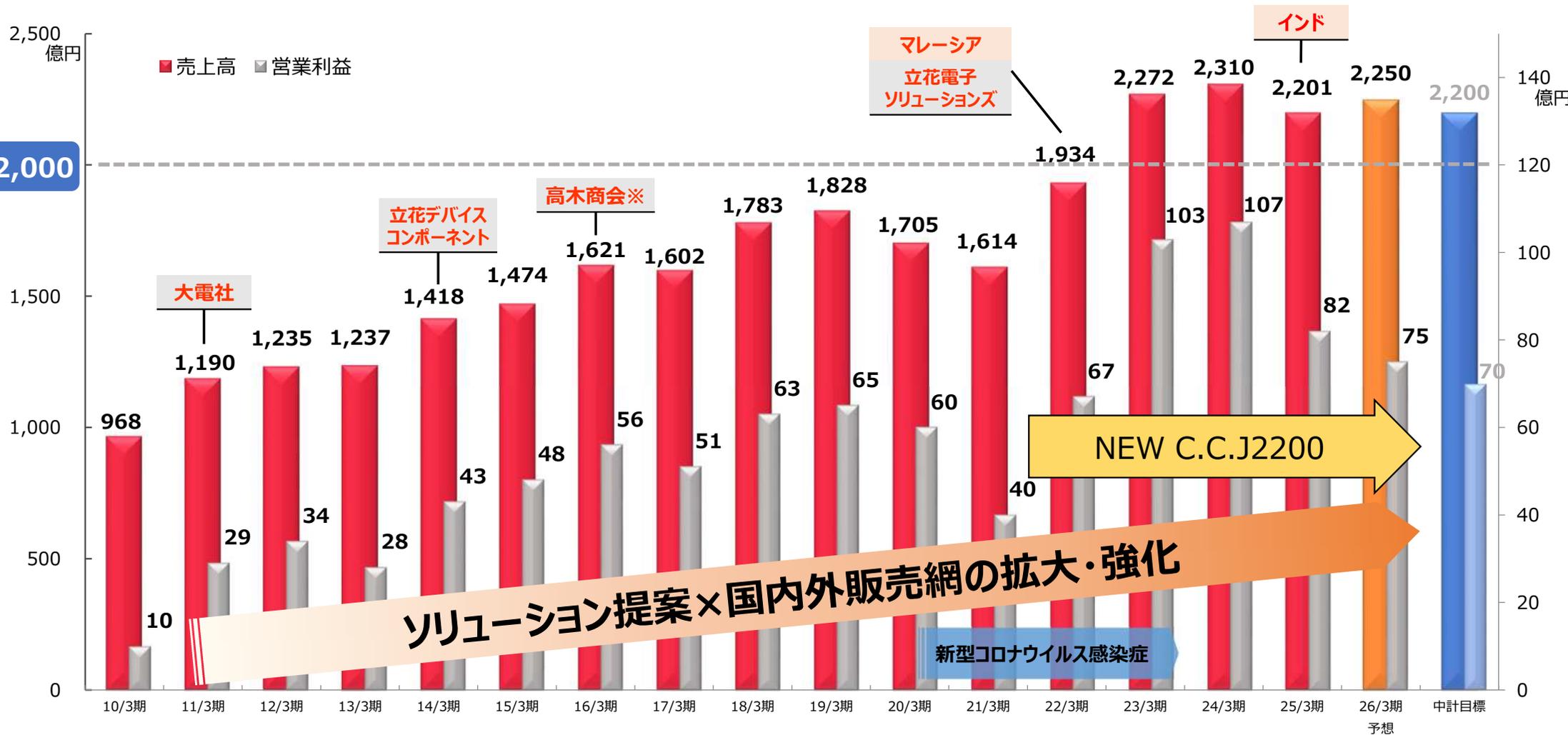
×

体質改善のための
基盤強化
①OA・DX②人事制度

×

常に2,000億円以上の
売上を維持できる
プラットフォーム作り

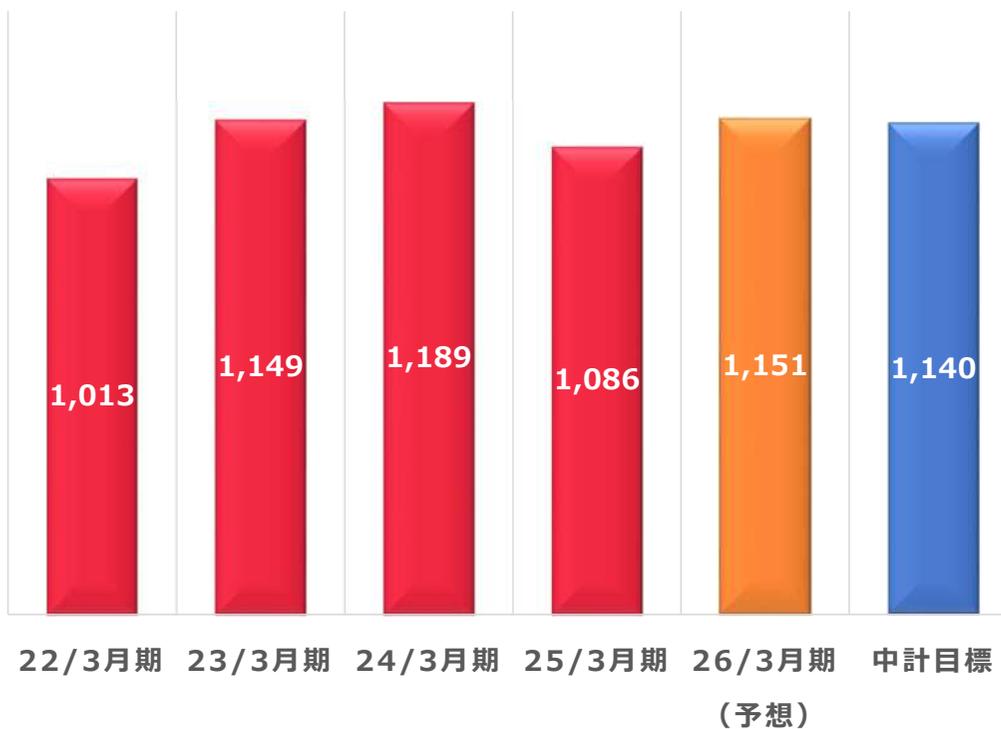
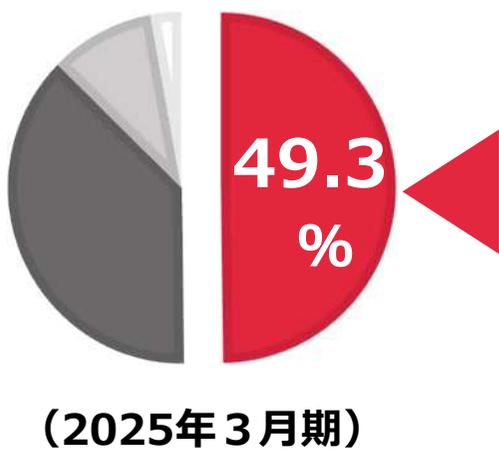
連結業績の推移



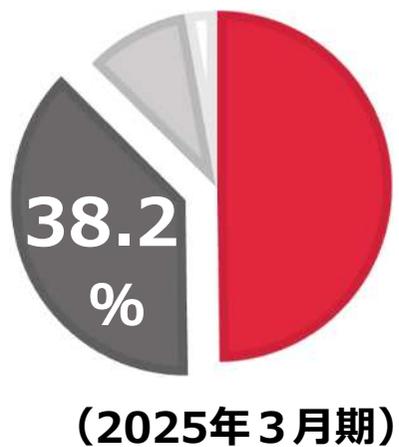
※高木商会は2025年4月にタガギコネクに社名変更

●FAシステム事業

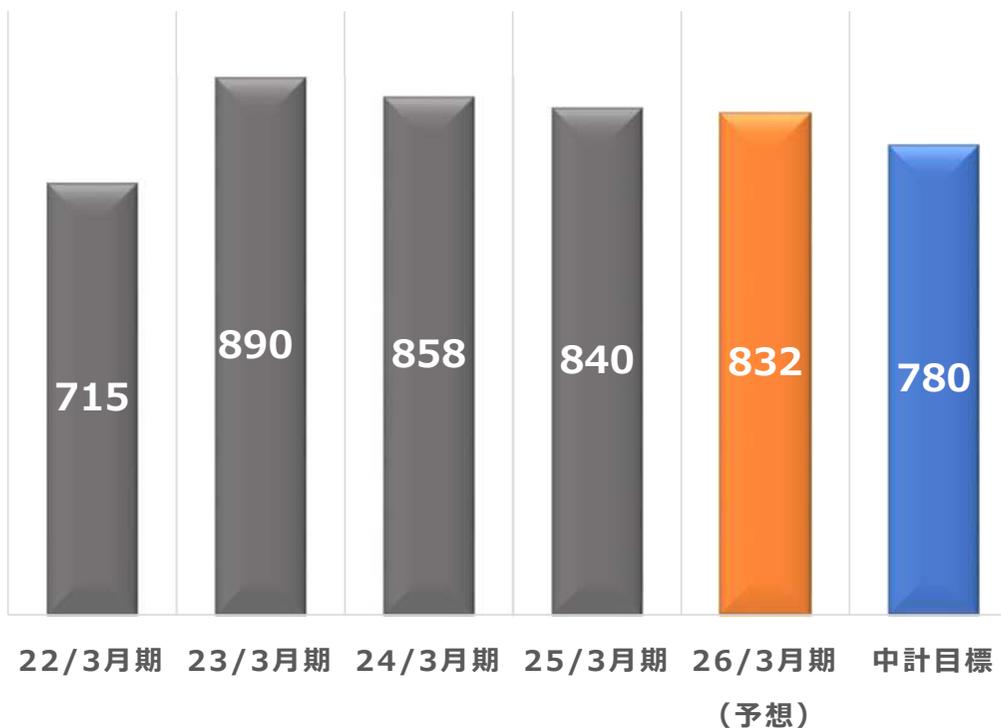
中計期間の業績推移 (単位: 億円)



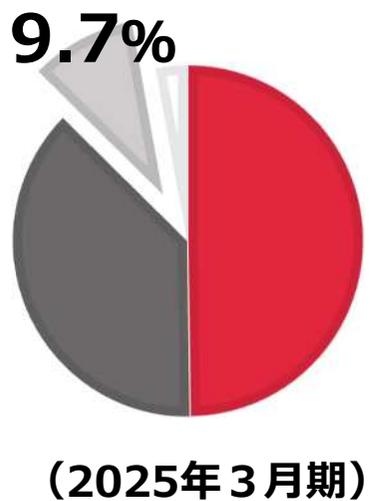
● 半導体デバイス事業



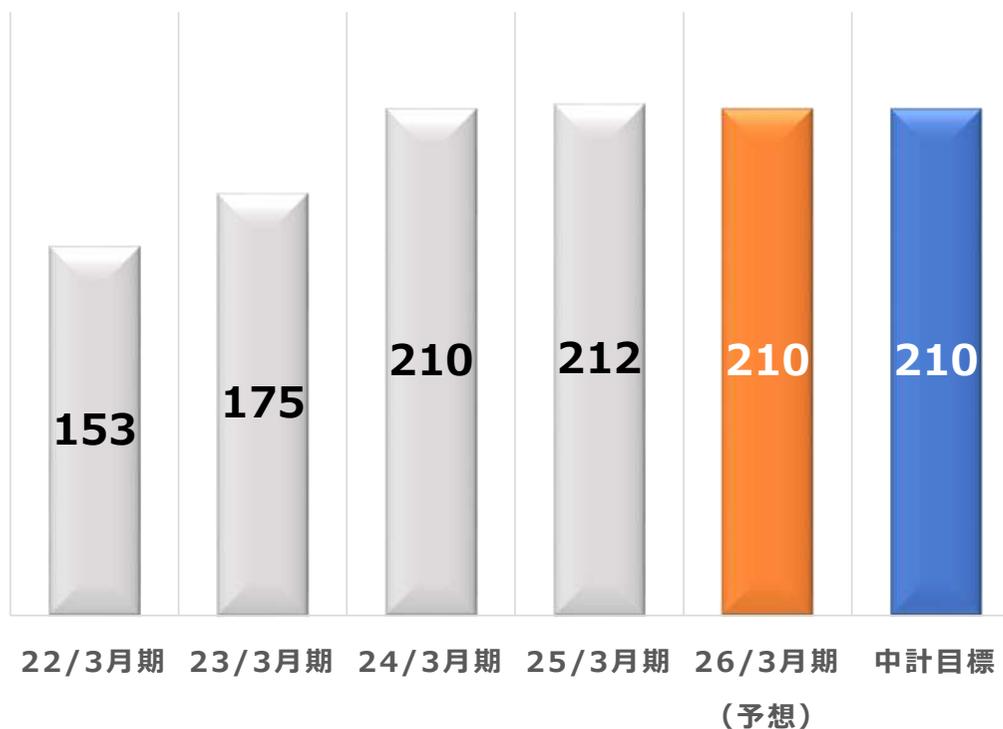
中計期間の業績推移 (単位：億円)



● 施設事業



中計期間の業績推移 (単位：億円)



一元的対応



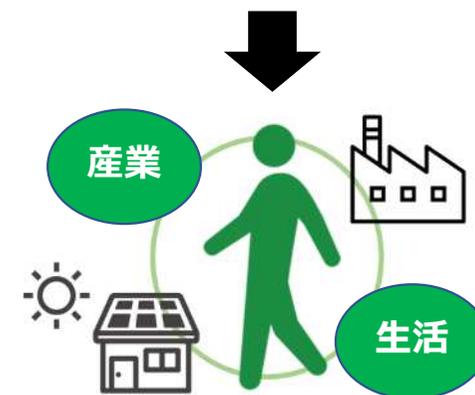
設計



施工



メンテナンス



新しい時代に適合した営業戦略

各事業の目指す姿

① F Aシステム事業

『F Aといえば立花』
『M 2 Mと言えば立花』

② 半導体デバイス事業

高い技術力と営業力
強い半導体専門商社

③ 施設事業

第三の柱として主要事業化

④ M S 事業

「ものづくり商社」

⑤ 海外事業

拠点のローカル化

重点取り組み

M 2 Mビジネス、システムビジネス、
ロボットビジネス、
3 Dプリンタービジネス

品揃えの強化、保有技術力の
ブラッシュアップ

地域のサービスレベルの均一化

アジアでの製造委託先開拓

アジアのローカルマーケット開拓

体質改善のための基盤強化

① 社内実務のOA化

② 新しい時代を見据えた
人事制度改革

単純作業からの脱却を図り、より高度な業務、
将来の発展のための業務へと人材の流動化を促進

- ・ 変化する時代に適合する人材の育成
- ・ 利益生産性を高め、高収益体質へと変革する
- ・ ガバナンスに重点をおいて、経営体質を強化する

TOP VISION

立花DX目指すGOAL

真のグローバル技術商社として
強固なDXプラットフォームを確立し安定成長を遂げる

新たな価値を提供する「攻めのDX」へ

IT・デジタル技術を駆使し、販売拡大、コスト削減、CS向上など
取引先へ新たな価値を提供し成長を遂げる



2つのDXプラットフォーム

立花DXプラットフォーム

情報・ノウハウを可視化し、意思決定スピードを向上させる

- 社員が業界の変化に早く気づきSPEEDのある判断、行動が行えるような仕組みを構築する
- その為に経験ある社員の情報取得方法、意思決定のノウハウを可視化し活用し社員のレベル向上を図る

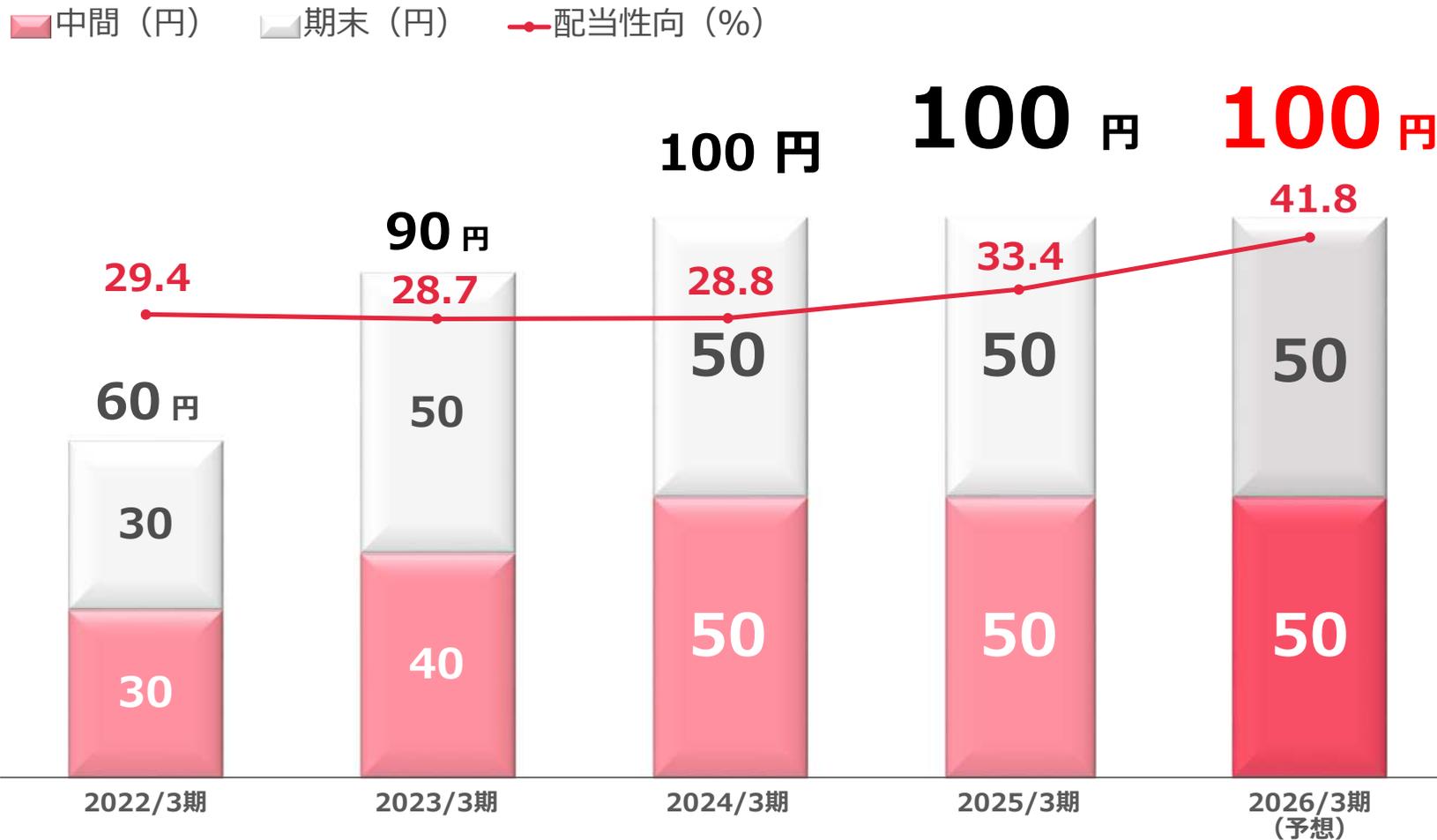
ITプラットフォーム

オペレーションの効率化とデータ基盤の整備

- 全社レベルの情報の一元化/標準化
- 立花DXのためのITプラットフォーム構築

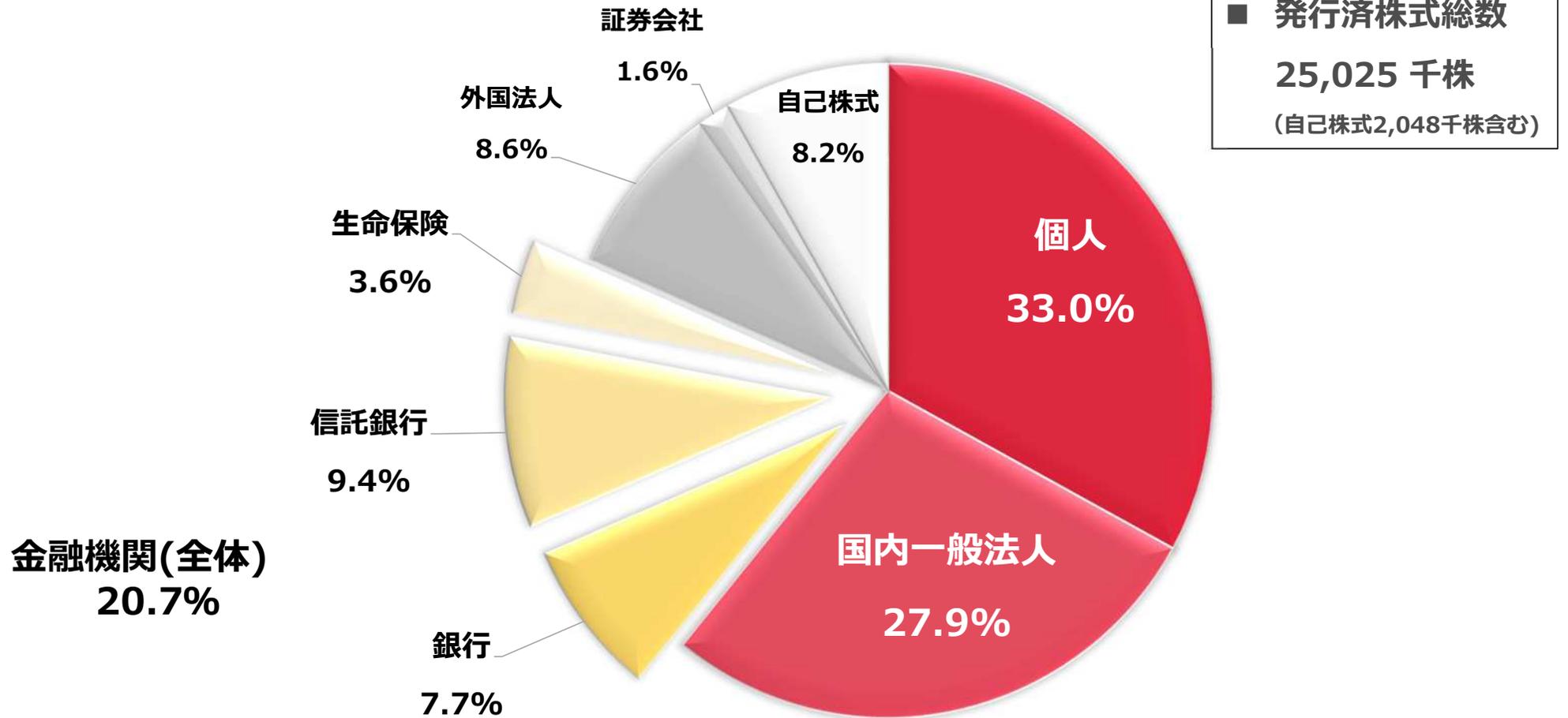
04 株主還元/株式情報

配当金、配当性向の推移



株式の概況（2025年3月末）

■ 所有者別株式分布状況



* 「個人」は従業員持株会、役員持株会も含む

自己株式取得について

方針（2023年6月5日発表）

- 3年間で300万株の自己株式を取得
（2026年3月期迄。発行済株式総数の12%）
- 同期間の総還元性向50%以上

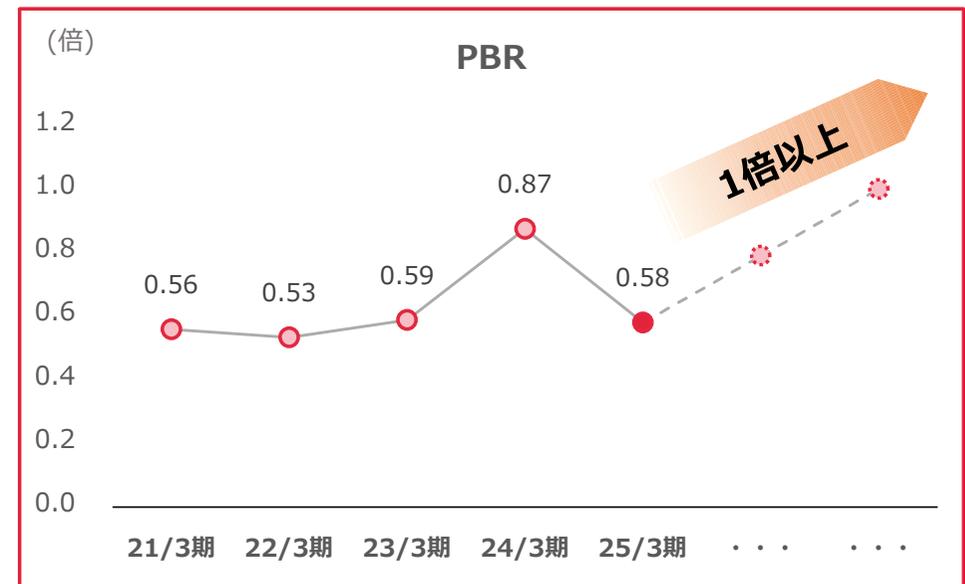
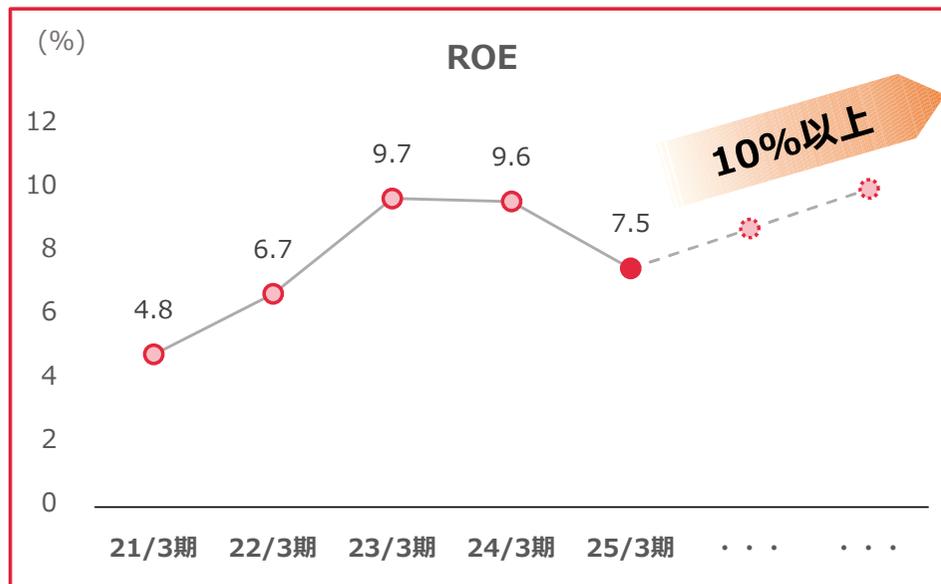
進捗（2025年3月末時点）



05 トピックス

ROE、PBRの推移

- ROEは上昇傾向にあり、25年3月期は7.5%
 - ROE10%を目指す
 - ソリューション提案の強化により、収益基盤のさらなる向上
 - PBRは自己株式取得などの施策による株価上昇に伴い向上
 - PBR 1倍以上を目指す
- ①資本効率向上と株主還元強化 ②積極的なIR活動の展開



今後のグローバル展開

■ 目標

- ・ アジアの産業界を支える「一大技術商社」
- ・ 海外関連売上高比率

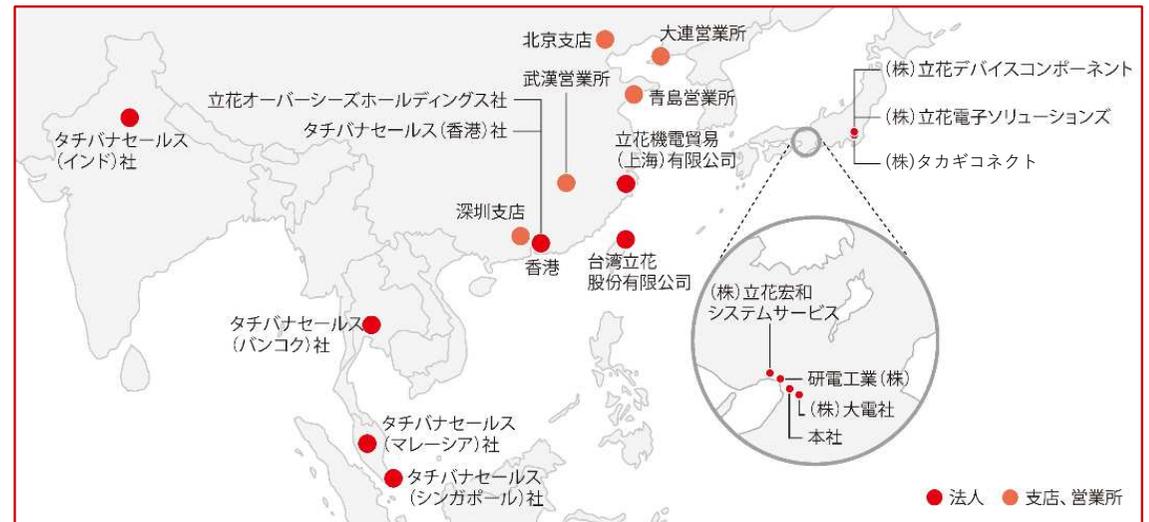


中国・ASEANからインド進出へ

進出が続く日系企業の生産ラインやR&Dセンターへの部材供給を目指す



2025年1月
タチバナセールス（インド）社の営業を開始



サステナビリティの推進 / マテリアリティの特定

当社企業グループでは、持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識に立ち、社会課題を解決し持続可能な環境や社会の実現に貢献すべくサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ活動の推進に鋭意取り組む。

分野	マテリアリティ	重点テーマ（施策）	SDG sとの対応
(E) 環境	環境配慮型製品の拡販 ～資源の集中による徹底的な深掘	【FAシステム事業】ソリューションビジネスの拡大	 
		【半導体デバイス事業】半導体技術部門活動の拡大	
		【施設事業】再生エネルギーへの貢献	
	CO2削減への取組み	照明・空調設備の節電取組み	
		Scope1削減	
(S) 社会	人基軸経営の深化	人財育成に資する研修実施 (人的資本増強への対応)	 
	地域社会とともに発展・成長の実現	なごみ会活動・地域貢献活動の推進	 
(G) ガバナンス	経営体制の有効性と透明性を追求	コーポレートガバナンスの強化	
	コンプライアンスの強化	従業員へのコンプライアンス研修の実施	

サステナビリティの推進 ～社会分野活動～

「なごみ会」 — 各種活動を通して社会と積極的に関わることにより、社員が当社を自慢に思える会社を目指す

■ 2024年度の活動実績

時期	支援内容	詳細
2024年 6月	令和6年 能登半島地震	被害者及び被災地の支援金（従業員募金6万、会社支援24万）
9月	フェンシング 松山恭助選手	当社がスポンサーである松山選手の金メダルをお祝いする祝い金と費用の支援
10月	令和6年 能登半島豪雨	能登半島地震で被災された方々が未曾有の二重災害に遭った事に対し、被災地における更なる救援・復興活動の支援
11月	社員以外の方々	慶弔関係（結婚・出産など）の支援 ➡制度拡充
12月	産経子どもニュース	地域貢献活動を進めるために大阪市西区の小学校に「産経子どもニュース（壁新聞）」を掲示する掲示板を寄贈
2025年 1月	介護休業取得の方	ご家族の病気により、そのサポートが必要となったため、介護休業を取得する社員に対し、お見舞金による休業中の支援を行いました。

【参考情報】大規模展示会への出展

FAシステム事業

『FOOMA JAPAN 2024』 2年連続

- 会期：2024年6月
- 場所：東京ビッグサイト
- 当社ブース来場者：1,405名
- 商談件数：59件



「IoT、M2Mシステム
技術に強い」
電機・機械・電子・情報の
技術商社として、
変革期にある食品業界の
ニーズに迅速に応える

半導体デバイス事業

『EdgeTech+ 2024』 9年連続

- 会期：2024年11月
- 場所：パシフィコ横浜
(オンライン展示、Webinarを併設)
- 当社ブース来場者：1,726名 (オンライン含む)
- 商談件数：44件

※2024年7月『EdgeTech+
WEST2024』(大阪)出展



展開豊富なEGNA
シリーズを中心に話題
の要素技術を展示
⇒無線技術
(LoRa/BLE)/エッジ
AI技術(画像認識)など

〈今年度出展計画〉

- ・ 出展済：関西物流展 (4月/施設事業) MEX金沢 (5月/半導体デバイス事業)
- ・ 出展予定：FOOMA JAPAN2025 (6月) Edge Tech+ WEST 2025 (7月) /EdgeTech+ 2025 (11月)

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

(株)立花エレテック 広報 I R 部

Tel: (06)6539-2718 Fax: (06)6539-8820

当社ホームページはこちらから⇒



本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは異なる結果となることをご承知おきください。